

股票代碼：5425

台灣半導體股份有限公司及子公司
合併財務報告暨會計師核閱報告
民國一十二年及一十一年第一季

公司地址：新北市新店區北新路三段205號11樓
電話：(02)89131588

目 錄

項 目	頁 次
一、封 面	1
二、目 錄	2
三、會計師核閱報告書	3
四、合併資產負債表	4
五、合併綜合損益表	5
六、合併權益變動表	6
七、合併現金流量表	7
八、合併財務報告附註	
(一)公司沿革	8
(二)通過財務報告之日期及程序	8
(三)新發布及修訂準則及解釋之適用	8
(四)重大會計政策之彙總說明	9~10
(五)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	11
(六)重要會計項目之說明	11~36
(七)關係人交易	36
(八)質押之資產	36
(九)重大或有負債及未認列之合約承諾	37
(十)重大之災害損失	37
(十一)重大之期後事項	37
(十二)其 他	37
(十三)附註揭露事項	
1.重大交易事項相關資訊	37~40
2.轉投資事業相關資訊	40~41
3.大陸投資資訊	42
4.主要股東資訊	42
(十四)部門資訊	43



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師核閱報告

台灣半導體股份有限公司董事會 公鑒：

前言

台灣半導體股份有限公司及其子公司民國一一二年及一一一年三月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。

範圍

除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

保留結論之基礎

如合併財務報告附註四(二)所述，列入上開合併財務報告之部份非重要子公司，係依該等被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報告為依據，民國一一二年及一一一年三月三十一日之資產總額分別為2,885,126千元及2,780,149千元，分別占合併資產總額之15.88%及16.72%；負債總額分別為517,503千元及528,184千元，分別占合併負債總額之7.31%及7.78%；民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日之綜合損益分別為46,842千元及145,875千元，分別占合併綜合損益之13.11%及21.17%。

保留結論

依本會計師核閱結果及其他會計師之核閱報告(請參閱其他事項段)，除保留結論之基礎段所述該等被投資公司財務報告倘經會計師核閱，對合併財務報告可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達台灣半導體股份有限公司及其子公司民國一一二年及一一一年三月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日之合併財務績效及合併現金流量之情事。

其他事項

列入上開合併財務報告之子公司中，有關鼎翰科技股份有限公司之財務報告未經本會計師核閱，而係由其他會計師核閱，因此，本會計師對上開合併財務報告之核閱結果，有關鼎翰科技股份有限公司之財務報告所列之金額係依據其他會計師之核閱報告。鼎翰科技股份有限公司於民國一一二年及一一一年三月三十一日之資產總額分別為7,101,684千元及6,647,638千元，分別占合併資產總額之39.10%及39.98%；於民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日之營業收入淨額分別為1,908,045千元及1,762,083千元，分別占合併營業收入淨額之52.63%及46.96%。

安侯建業聯合會計師事務所

郭仰倫



會計師：

蕭佩如



證券主管機關：金管證審字第1120333238號

核准簽證文號：金管證審字第1040003949號

民國一一二年五月十日

民國一十二年及一十一年三月三十一日經核閱，未依審計準則查核
台灣半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十二年三月三十一日、一十一年十二月三十一日及三月三十一日

單位：新台幣千元

	112.3.31		111.12.31		111.3.31			112.3.31		111.12.31		111.3.31	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產							負債及權益						
流動資產：							流動負債：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 3,386,616	19	3,595,681	20	2,471,703	15	2100 短期借款(附註六(十))	\$ 1,379,471	7	1,466,515	8	944,529	6
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	516,413	3	1,798	-	251,835	1	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二))	5,607	-	2,392	-	7,443	-
1150 應收票據淨額(附註六(三)及(十八))	319	-	588	-	584	-	2170 應付帳款	1,560,662	8	1,648,557	9	1,740,311	10
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(十八))	2,866,262	16	3,015,880	17	3,219,395	19	2200 其他應付款(附註六(十二))	863,714	5	1,065,266	6	744,782	4
1200 其他應收款	91,752	1	105,789	1	88,589	1	2230 本期所得稅負債	512,468	3	415,066	2	517,426	3
1220 本期所得稅資產	492	-	409	-	961	-	2322 一年內到期長期借款(附註六(十一))	312,249	2	322,349	2	-	-
130X 存貨(附註六(四))	3,609,217	20	3,500,033	19	2,778,071	17	2280 租賃負債—流動(附註六(十三))	109,545	1	106,012	-	96,890	1
1410 預付款項	270,959	1	251,545	1	190,788	1	2399 其他流動負債	313,484	2	325,900	2	285,590	2
1476 其他金融資產—流動(附註六(二))	389,928	2	599,488	3	446,094	3		5,057,200	28	5,352,057	29	4,336,971	26
	<u>11,131,958</u>	<u>62</u>	<u>11,071,211</u>	<u>61</u>	<u>9,448,020</u>	<u>57</u>	非流動負債：						
非流動資產：							2540 長期借款(附註六(十一))	965,820	5	1,084,391	6	1,429,310	9
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	4,122	-	-	-	-	-	2580 租賃負債—非流動(附註六(十三))	102,200	1	123,214	1	177,836	1
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	-	-	4,157	-	-	-	2640 淨確定福利負債—非流動	34,924	-	35,000	-	42,016	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	4,417,745	24	4,483,033	25	4,502,295	27	2570 遞延所得稅負債	827,239	4	825,106	5	733,664	4
1755 使用權資產(附註六(七))	208,528	1	229,239	1	264,966	1	2670 其他非流動負債	92,577	1	71,568	-	73,453	-
1822 無形資產(附註六(八))	289,446	2	308,413	2	371,420	2		2,022,760	11	2,139,279	12	2,456,279	14
1805 商譽(附註六(九))	1,126,943	6	1,136,565	6	1,059,400	6		7,079,960	39	7,491,336	41	6,793,250	40
1840 遞延所得稅資產	487,165	3	458,165	3	461,566	3	負債總計						
1980 其他金融資產—非流動(附註六(二))	83,194	-	83,020	-	84,312	1	歸屬母公司業主之權益：(附註六(十六))						
1990 其他非流動資產	415,276	2	443,016	2	435,954	3	3110 普通股股本	2,634,854	15	2,634,854	14	2,634,854	16
	<u>7,032,419</u>	<u>38</u>	<u>7,145,608</u>	<u>39</u>	<u>7,179,913</u>	<u>43</u>	3200 資本公積	2,136,998	12	2,137,088	12	2,097,317	13
資產總計	<u>\$ 18,164,377</u>	<u>100</u>	<u>18,216,819</u>	<u>100</u>	<u>16,627,933</u>	<u>100</u>	3300 保留盈餘	4,385,908	24	4,155,591	23	3,633,153	22
							3400 其他權益	(355,057)	(2)	(359,558)	(2)	(373,297)	(2)
							3500 庫藏股票	(506,043)	(3)	(506,043)	(3)	(506,085)	(3)
								8,296,660	46	8,061,932	44	7,485,942	46
							36XX 非控制權益(附註六(五))	2,787,757	15	2,663,551	15	2,348,741	14
							權益總計	11,084,417	61	10,725,483	59	9,834,683	60
							負債及權益總計	<u>\$ 18,164,377</u>	<u>100</u>	<u>18,216,819</u>	<u>100</u>	<u>16,627,933</u>	<u>100</u>

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭

(請詳閱後附合併財務報告附註)



~4~

會計主管：鄭懿誠



僅經核閱，未依審計準則查核
台灣半導體股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	112年1月至3月		111年1月至3月	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註六(十八))	\$ 3,788,547	105	3,891,420	104
4190 減：銷貨退回及折讓	163,184	5	139,492	4
營業收入淨額	3,625,363	100	3,751,928	100
5000 營業成本(附註六(四))	2,500,051	69	2,521,731	67
營業毛利	1,125,312	31	1,230,197	33
6000 營業費用(附註六(十四)及(二十))：				
6100 推銷費用	338,722	9	318,287	9
6200 管理費用	205,921	6	200,352	5
6300 研究發展費用	91,192	2	85,511	2
	635,835	17	604,150	16
營業淨利	489,477	14	626,047	17
營業外收入及支出(附註六(十九))：				
7100 利息收入	8,046	-	3,328	-
7010 其他收入	19,800	1	11,982	-
7020 其他利益及損失	(5,773)	-	50,915	1
7050 財務成本	(17,316)	(1)	(7,079)	-
	4,757	-	59,146	1
稅前淨利	494,234	14	685,193	18
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	133,841	4	200,194	5
本期淨利	360,393	10	484,999	13
8300 其他綜合損益：				
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(6,127)	-	222,304	6
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	2,996	-	(18,189)	1
後續可能重分類至損益之項目合計	(3,131)	-	204,115	5
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(3,131)	-	204,115	5
本期綜合損益總額	\$ 357,262	10	689,114	18
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 230,317	6	386,036	10
非控制權益(附註六(五))	130,076	4	98,963	3
	\$ 360,393	10	484,999	13
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 234,818	7	543,864	14
非控制權益(附註六(五))	122,444	3	145,250	4
	\$ 357,262	10	689,114	18
基本每股盈餘(元)(附註六(二十一))	\$ 0.93		1.55	
稀釋每股盈餘(元)(附註六(二十一))	\$ 0.92		1.54	

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：王秀亭

~5~



會計主管：鄭懿誠



僅經核閱，未依審計準則查核
台灣半導體股份有限公司及子公司
合併權益變動表

民國一一年及一二年一月一日起至三月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	股本		保留盈餘				國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計					
民國一一年一月一日餘額	\$ 2,650,854	2,166,799	884,887	459,300	1,902,930	3,247,117	(531,125)	(506,990)	7,026,655	2,200,854	9,227,509
本期淨利	-	-	-	-	386,036	386,036	-	-	386,036	98,963	484,999
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	157,828	-	157,828	46,287	204,115
本期綜合損益總額	-	-	-	-	386,036	386,036	157,828	-	543,864	145,250	689,114
庫藏股註銷	(16,000)	(69,482)	-	-	-	-	-	85,482	-	-	-
子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(84,577)	(84,577)	-	(84,577)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,637	2,637
民國一一年三月三十一日餘額	\$ 2,634,854	2,097,317	884,887	459,300	2,288,966	3,633,153	(373,297)	(506,085)	7,485,942	2,348,741	9,834,683
民國一二年一月一日餘額	\$ 2,634,854	2,137,088	973,024	531,125	2,651,442	4,155,591	(359,558)	(506,043)	8,061,932	2,663,551	10,725,483
本期淨利	-	-	-	-	230,317	230,317	-	-	230,317	130,076	360,393
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	4,501	-	4,501	(7,632)	(3,131)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	230,317	230,317	4,501	-	234,818	122,444	357,262
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	(90)	-	-	-	-	-	-	(90)	-	(90)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,762	1,762
民國一二年三月三十一日餘額	\$ 2,634,854	2,136,998	973,024	531,125	2,881,759	4,385,908	(355,057)	(506,043)	8,296,660	2,787,757	11,084,417

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭

(請詳閱後附合併財務報告附註)



~6~

會計主管：鄭懿誠



僅經核閱，未依審計準則查核
台灣半導體股份有限公司及子公司
合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	112年1月至3月	111年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 494,234	685,193
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	207,486	192,935
攤銷費用	34,078	32,848
預期信用減損損失（利益）	7,551	(1,293)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	4,398	14,983
利息費用	16,829	6,567
利息收入	(8,046)	(3,328)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	130	568
非金融資產減損迴轉利益	-	(711)
其他	(90)	-
收益費損項目合計	262,336	242,569
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(515,763)	(104,871)
應收票據減少	269	167
應收帳款（增加）減少	142,067	(267,287)
其他應收款（增加）減少	15,779	(25,321)
存貨增加	(109,184)	(333,246)
預付款項增加	(41,892)	(15,095)
其他金融資產（增加）減少	209,560	(72,510)
應付票據減少	-	(1,607)
應付帳款增加（減少）	(87,895)	66,762
其他應付款減少	(201,922)	(138,317)
其他流動負債增加（減少）	(12,418)	52,849
淨確定福利負債減少	(76)	(772)
其他非流動負債增加	21,381	19,851
調整項目合計	(317,758)	(576,828)
營運產生之現金流入	176,476	108,365
收取之利息	6,304	3,344
支付之利息	(14,499)	(4,095)
支付之所得稅	(63,389)	(52,065)
營業活動之淨現金流入	104,892	55,549
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(45,093)	(75,584)
處分不動產、廠房及設備	302	1,632
其他金融資產增加	(174)	(12,729)
取得無形資產	(16,694)	(8,183)
其他非流動資產（增加）減少	25,088	(7,417)
預付設備款增加	(40,783)	(66,790)
投資活動之淨現金流出	(77,354)	(169,071)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加（減少）	(87,044)	23,103
舉借長期借款	50,000	-
償還長期借款	(178,671)	(120,000)
租賃本金償還	(24,345)	(38,694)
存入保證金增加	4	171
庫藏股票買回成本	-	(84,577)
非控制權益淨變動	1,762	2,637
籌資活動之淨現金流出	(238,294)	(217,360)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,691	100,937
本期現金及約當現金減少數	(209,065)	(229,945)
期初現金及約當現金餘額	3,595,681	2,701,648
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,386,616	2,471,703

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：王秀亭



~7~

會計主管：鄭懿誠



僅經核閱，未依審計準則查核
台灣半導體股份有限公司及子公司
合併財務報告附註
民國一十二年及一十一年第一季
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

台灣半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國六十八年一月依中華民國公司法設立，註冊地址為新北市新店區北新路3段205號11樓。本公司股票於民國八十九年二月在中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱「櫃買中心」)掛牌交易。

本公司為透過業務及組織重組，朝向專業分工，以提升企業經營效率及產業競爭力，將條碼印表機事業處以新設分割方式，分割予新設之鼎翰科技股份有限公司(以下稱「鼎翰科技」)；經董事會決議訂定分割基準日為民國九十六年八月一日。

本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為整流器之製造與買賣業務及自動辨識系統產品製造與服務。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國一十二年五月十日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

合併公司自民國一十二年一月一日起開始適用下列新修正之國際財務報導準則，且對合併財務報告未造成重大影響。

- 國際會計準則第1號之修正「會計政策之揭露」
- 國際會計準則第8號之修正「會計估計值之定義」
- 國際會計準則第12號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」

(二)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

合併公司預期下列尚未認可之新發布及修正準則不致對合併財務報告造成重大影響。

- 國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」
- 國際財務報導準則第17號「保險合約」及國際財務報導準則第17號之修正
- 國際會計準則第1號之修正「將負債分類為流動或非流動」
- 國際會計準則第1號之修正「具合約條款之非流動負債」
- 國際財務報導準則第17號之修正「初次適用IFRS 17及IFRS 9比較資訊」
- 國際財務報導準則第16號之修正「售後租回交易之規定」

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下稱「編製準則」)及金管會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。本合併財務報告未包括依照金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下稱「金管會認可之國際財務報導準則」)所編製之整份年度合併財務報告應揭露之全部必要資訊。

本合併財務報告所採用之重大會計政策與民國一一一年度合併財務報告相同，相關資訊請參閱民國一一一年度合併財務報告。

(二) 合併基礎

1. 列入本合併財務報告之子公司包含：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比		
			112.3.31	111.12.31	111.3.31
本公司	Ever Energetic Int'l Ltd. (Ever Energetic)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
本公司	Ever Winner Int'l Co., Ltd. (Ever Winner)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
本公司	Skyrise Int'l Ltd. (Skyrise)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
本公司	Taiwan Semiconductor Europe GmbH (TSCE)	一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
本公司	Taiwan Semiconductor Japan Ltd. (TSCJ)	整流器之買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
本公司	Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd. (TSCH)	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	25.22 %	25.22 %	25.22 %
本公司	鼎翰科技	條碼印表機之製造及買賣業務	36.34 %	36.35 %	36.38 %
Ever Energetic	TSCH	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	36.96 %	36.96 %	36.96 %
Ever Energetic	TSC America, Inc.(TSCA)	整流器之買賣業務	75.00 %	75.00 %	75.00 %
Ever Winner	TSCH	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	37.82 %	37.82 %	37.82 %
Ever Winner	TSCA	整流器之買賣業務	25.00 %	25.00 %	25.00 %
Ever Winner	上海瀚科國際貿易有限公司(上海瀚科)	整流器之買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
TSCH	陽信長威電子有限公司(陽信長威)	整流器之製造及買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
TSCH	天津長威科技有限公司(天津長威)	晶片之製造及買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技	TSC Auto ID Technology EMEA GmbH (TSCAE)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技	TSC Auto ID (H.K.) Ltd. (TSC HK)	各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技	TSC Auto Technology America Inc. (TSCAA)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技	鼎貫科技股份有限公司(鼎貫科技)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技及TSCAA	Printronic Auto ID Technology Inc. (PTNX US)	條碼印表機及其零件之買賣	-	-	100.00 %
鼎翰科技	Diversified Labeling Solutions, Inc. (DLS)	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	100.00 %	100.00 %	100.00 %

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比		
			112.3.31	111.12.31	111.3.31
鼎翰科技	TSC Auto ID Technology India Private limited (TSCIN)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
鼎翰科技	Mosfortico Investments sp. z o.o. (TSCPL)	一般投資	100.00 %	-	-
TSCAE	TSC Auto ID Technology ME, Ltd. FZE (TSCAD)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
TSCAE	TSC Auto ID Technology Spain, S.L. (TSCAS)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
TSC HK	天津國聚科技有限公司(天津國聚)	條碼印表機及其零件之產銷	100.00 %	100.00 %	100.00 %
TSC HK	深圳鼎貫科技有限公司(深圳鼎貫)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %
DLS	Precision Press & Label, Inc. (PPL)	印表機各式標籤紙及其耗材之銷售	100.00 %	100.00 %	100.00 %

- 2.未列入合併財務報告之子公司：無。
- 3.為簡化集團組織架構及增進營運效率，經鼎翰科技董事會於民國一一一年六月二十八日決議，將鼎翰科技持有美國孫公司PTNX US之5%股權移轉予美國子公司TSCAA，轉讓對價為美金1,620千元，股份轉讓完成後，以民國一一一年七月一日為合併基準日，TSCAA吸收合併持股100%之子公司PTNX US。此合併性質屬共同控制下之集團內組織重組，不影響合併公司財務報表之編製，請詳附註六(二十二)。
- 4.鼎翰科技於民國一一二年二月新設立Mosfortico Investments sp. z o.o.(TSCPL)，設立資本額為波蘭幣4,520元(折合新台幣31千元)，預計透過TSCPL取得波蘭公司MGN sp. z o.o.(MGN)之100%股權，截至本合併財務報告通過發布日止，鼎翰科技已與賣方簽訂此股份收購協議，初始收購對價為波蘭幣54,000千元或與其等值之歐元，惟交易總價金尚可能依照交割後與MGN未來三年營利條件有關之或有對價及其他合約所訂情形增減。

(三)所得稅

合併公司係依國際會計準則公報第34號「期中財務報導」第B12段規定衡量及揭露期中期間之所得稅費用。

所得稅費用係以期中報導期間之稅前淨利乘以管理階層對於全年度預計有效稅率之最佳估計衡量，並依預計全年度當期所得稅費用及遞延所得稅費用之比例分攤為當期所得稅費用及遞延所得稅費用。

所得稅費用係直接認列於權益項目或其他綜合損益項目者，係就相關資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異，以預期實現或清償時之適用稅率予以衡量。

(四)員工福利

期中期間之確定福利計畫退休金係採用前一年度報導期間結束日(以下稱報導日)依精算決定退休金成本率，以年初至當期期末為基礎計算，並針對該報導日後之重大市場波動，及重大縮減、清償或其他重大一次性事項加以調整。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依編製準則及金管會認可之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製本合併財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費損之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

編製合併財務報告時，管理階層於採用合併公司會計政策時所作之重大判斷以及估計不確定性之主要來源與民國一一一年度合併財務報告一致。

六、重要會計項目之說明

除下列所述外，本合併財務報告重要會計項目之說明與民國一一一年度合併財務報告尚無重大差異，相關資訊請參閱民國一一一年度合併財務報告。

(一)現金及約當現金

	112.3.31	111.12.31	111.3.31
現金及零用金	\$ 776	476	569
支票及活期存款	2,315,969	2,507,863	2,384,514
定期存款	869,871	587,342	86,620
附買回票券	200,000	500,000	-
	\$ 3,386,616	3,595,681	2,471,703

合併公司金融資產及負債之利率風險及敏感度分析之揭露請詳附註六(二十三)。

(二)金融資產及負債

1.明細如下：

	112.3.31	111.12.31	111.3.31
流 動：			
強制透過損益按公允價值衡量			
之金融資產：			
受益憑證	\$ 250,198	-	250,090
理財產品	265,860	-	-
遠期外匯合約	355	-	1,745
換匯交易	-	1,798	-
	\$ 516,413	1,798	251,835
其他金融資產：			
結構性定期存款	\$ 389,928	599,488	446,094
非 流 動：			
強制透過損益按公允價值衡量			
之金融資產：			
國外基金	\$ 4,122	-	-

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	112.3.31	111.12.31	111.3.31
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產：			
國外基金	\$ -	4,157	-
其他金融資產：			
存出保證金	\$ 83,194	83,020	84,312
流動：			
強制透過損益按公允價值衡量之金融負債：			
遠期外匯合約	\$ 3,066	844	4,075
換匯交易	2,541	1,548	3,368
	\$ 5,607	2,392	7,443

合併公司已於附註六(二十三)揭露與金融工具相關之信用、貨幣及利率暴險。

2. 從事衍生金融工具係因以規避營業活動所暴露之匯率風險，合併公司因未適用避險會計列報為強制透過損益按公允價值衡量之金融資產及持有供交易之金融負債之衍生工具明細如下：

112.3.31					
		合約金額		幣別	到期期間
賣出/買入遠期外匯	USD	6,000 / NTD	179,480	美元兌台幣	112.04~112.05
賣出/買入遠期外匯	EUR	2,000 / NTD	65,181	歐元兌台幣	112.04.20
賣出/買入遠期外匯	USD	4,000 / NTD	120,414	美元兌台幣	112.04~112.05
111.12.31					
		合約金額		幣別	到期期間
賣出/買入遠期外匯	EUR	500 / USD	521	歐元兌美元	112.02.17
賣出/買入遠期外匯	USD	2,000 / NTD	60,718	美元兌台幣	112.02.17
換匯交易	USD	7,200 / NTD	219,593	美元兌台幣	112.02~112.05
111.3.31					
		合約金額		幣別	到期期間
賣出/買入遠期外匯	USD	8,000 / CNY	51,100	美元兌人民幣	111.04~111.07
賣出/買入遠期外匯	EUR	1,000 / NTD	31,423	歐元兌台幣	111.04.05
賣出/買入遠期外匯	USD	5,000 / NTD	139,474	美元兌台幣	111.04~111.05
賣出/買入遠期外匯	EUR	1,000 / USD	1,148	歐元兌美元	111.04.22
換匯交易	USD	11,500 / NTD	325,181	美元兌台幣	111.05~111.08

3. 本公司持有之結構性定期存款係以透過損益按公允價值衡量，截至民國一一二年三月三十一日、一一一年十二月三十一日及三月三十一日止，因承作天期短，故其帳面金額係公允價值之合理近似值。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

4.本公司持有國外基金，因非屬權益工具投資且未能符合債務工具之合約現金流量特性，故於民國一一二年三月三十一日轉列於強制透過損益按公允價值衡量之金融資產。

(三)應收票據及應收帳款

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
應收票據	\$ 319	588	584
應收帳款	2,911,318	3,053,386	3,257,234
減：備抵損失	<u>(45,056)</u>	<u>(37,506)</u>	<u>(37,839)</u>
	<u>\$ 2,866,581</u>	<u>3,016,468</u>	<u>3,219,979</u>

合併公司針對所有應收票據及應收帳款採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收票據及應收帳款係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊。

合併公司整流器部門應收票據及應收帳款之預期信用損失分析如下：

	<u>112.3.31</u>		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,484,489	1.34%	19,962
逾期1~90天	139,593	1.32%	1,847
逾期91~180天	10,288	3.00%	308
逾期181~270天	24	5.00%	1
逾期365天以上	<u>461</u>	100.00%	<u>461</u>
	<u>\$ 1,634,855</u>		<u>22,579</u>

	<u>111.12.31</u>		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,512,691	1.13%	17,125
逾期1~90天	165,665	1.66%	2,758
逾期91~180天	7,826	3.16%	247
逾期271~365天	331	63.44%	210
逾期365天以上	<u>52</u>	100.00%	<u>52</u>
	<u>\$ 1,686,565</u>		<u>20,392</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	111.3.31		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,782,000	0.80%	14,333
逾期1~90天	137,644	0.94%	1,298
逾期91~180天	632	3.00%	19
逾期181~270天	25	5.00%	1
逾期271~365天	<u>5</u>	10.00%	<u>1</u>
	<u>\$ 1,920,306</u>		<u>15,652</u>

合併公司條碼列印機部門應收票據及應收帳款之預期信用損失分析如下：

	112.3.31		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 984,215	0.56%	5,510
逾期1~90天	248,992	1.00%	2,490
逾期91~180天	26,541	3.00%	1,792
逾期181~270天	2,812	5.00%	141
逾期271~365天	1,865	10.00%	187
逾期365天以上	<u>12,357</u>	100.00%	<u>12,357</u>
	<u>\$ 1,276,782</u>		<u>22,477</u>

	111.12.31		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 999,671	0.55%	5,530
逾期1~90天	339,761	1.00%	1,880
逾期91~180天	7,684	3.00%	1,523
逾期181~270天	2,186	5.00%	60
逾期271~365天	6,537	10.00%	362
逾期365天以上	<u>11,570</u>	100.00%	<u>7,759</u>
	<u>\$ 1,367,409</u>		<u>17,114</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	111.3.31		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 985,615	1.00%	8,277
逾期1~90天	281,604	1.00%	2,816
逾期91~180天	48,778	3.00%	1,463
逾期181~270天	9,521	5.00%	476
逾期271~365天	3,154	10.00%	315
逾期365天以上	8,840	100.00%	8,840
	\$ 1,337,512		22,187

合併公司應收票據及應收帳款之備抵損失變動表如下：

	<u>112年1月至3月</u>	<u>111年1月至3月</u>
期初餘額	\$ 37,506	39,430
本期認列(迴轉)	7,551	(1,293)
外幣換算損益	(1)	(298)
期末餘額	\$ 45,056	37,839

截至民國一一二年三月三十一日、一一一年十二月三十一日及三月三十一日止，合併公司應收票據及應收帳款均未貼現或作為擔保品。

(四)存 貨

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
製成品	\$ 1,703,000	1,588,815	1,122,050
半成品及在製品	688,360	636,075	562,847
原物料	1,124,241	1,061,904	978,136
在途存貨	93,616	213,239	115,038
	\$ 3,609,217	3,500,033	2,778,071

合併公司民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日認列為銷貨成本及費用之存貨成本分別為2,427,847千元及2,493,522千元。民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日因存貨自成本沖減至淨變現價值而認列之營業成本分別為72,204千元及28,209千元。

截至民國一一二年三月三十一日、一一一年十二月三十一日及三月三十一日止，合併公司之存貨均未有提供作質押擔保之情形。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(五)具重大非控制權益之子公司

子公司之非控制權益對合併公司具重大性者如下：

子公司名稱	公司註冊 之國家	非控制權益之所有權 權益及表決權之比例		
		112.3.31	111.12.31	111.3.31
鼎翰科技	台灣	63.66 %	63.65 %	63.62 %

上述子公司之彙總性財務資訊如下，該等財務資訊係依據金管會認可之國際財務報導準則所編製，該等財務資訊係合併公司間之交易尚未銷除前之金額：

彙總性財務資訊：

	112.3.31	111.12.31	111.3.31
流動資產	\$ 4,186,178	4,246,657	3,704,943
非流動資產	4,459,360	4,048,112	4,226,089
流動負債	(2,153,954)	(2,421,498)	(2,135,936)
非流動負債	(1,105,807)	(1,122,546)	(1,349,343)
淨資產	\$ <u>5,385,777</u>	<u>4,750,725</u>	<u>4,445,753</u>
非控制權益期末帳面金額	\$ <u>2,787,757</u>	<u>2,663,551</u>	<u>2,348,741</u>
		112年1月至3月	111年1月至3月
營業收入		\$ <u>1,908,049</u>	<u>1,762,091</u>
本期淨利		\$ 204,329	155,554
其他綜合損益		429,051	199,418
綜合損益總額		\$ <u>633,380</u>	<u>354,972</u>
歸屬於非控制權益之本期淨利		\$ <u>130,076</u>	<u>98,963</u>
歸屬於非控制權益之綜合損益總額		\$ <u>122,444</u>	<u>145,250</u>
營業活動現金流量		\$ 304,768	(52,365)
投資活動現金流量		(35,259)	(122,907)
籌資活動現金流量		(307,509)	(152,970)
匯率變動對現金及約當現金之影響		348	10,386
現金及約當現金淨減少數		\$ <u>(37,652)</u>	<u>(317,856)</u>

(六)不動產、廠房及設備

	土地	房屋 及建築	機器及 其他設備	總計
帳面金額：				
民國112年1月1日	\$ <u>861,426</u>	<u>905,203</u>	<u>2,716,404</u>	<u>4,483,033</u>
民國112年3月31日	\$ <u>861,426</u>	<u>896,254</u>	<u>2,660,065</u>	<u>4,417,745</u>
民國111年1月1日	\$ <u>861,426</u>	<u>940,531</u>	<u>2,699,178</u>	<u>4,501,135</u>
民國111年3月31日	\$ <u>861,426</u>	<u>944,828</u>	<u>2,696,041</u>	<u>4,502,295</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

- 1.截至民國一一二年三月三十一日、一一一年十二月三十一日及三月三十一日止合併公司之不動產、廠房及設備均未有提供作質押之情形。
- 2.本公司民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日購置固定資產利息費用資本化金額分別為53千元及218千元，資本化利率分別為1.50%及3.00%。

(七)使用權資產

帳面金額：	土地使用權	房屋及建築	運輸設備	總計
民國112年1月1日	\$ 8,583	216,465	4,191	229,239
民國112年3月31日	\$ 8,538	196,420	3,570	208,528
民國111年1月1日	\$ 8,814	266,977	4,874	280,665
民國111年3月31日	\$ 9,050	251,866	4,050	264,966

(八)無形資產

帳面金額：	專門技術	顧客關係	專利權	電腦軟體	商標權	合計
民國112年1月1日	\$ 43,557	160,327	6,326	98,203	-	308,413
民國112年3月31日	\$ 39,687	150,988	4,744	94,027	-	289,446
民國111年1月1日	\$ 54,265	190,632	12,652	130,467	-	388,016
民國111年3月31日	\$ 52,128	185,214	11,070	123,008	-	371,420

(九)商譽

成本	112.3.31	111.12.31	111.3.31
期初餘額	\$ 1,136,565	1,024,426	1,024,426
匯率變動之影響	(9,622)	112,139	34,974
期末餘額	\$ 1,126,943	1,136,565	1,059,400

合併公司已分攤商譽至整流器部門之現金產生單位及條碼列印機部門之現金產生單位，商譽總帳面金額之分攤列示如下：

	112.3.31	111.12.31	111.3.31
整流器部門現金產生單位	\$ 77,830	78,494	73,165
條碼列印機部門現金產生單位	1,049,113	1,058,071	986,235
	\$ 1,126,943	1,136,565	1,059,400

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十)短期借款

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
信用借款	\$ 1,288,121	1,466,515	830,029
進出口借款	91,350	-	114,500
	<u>\$ 1,379,471</u>	<u>1,466,515</u>	<u>944,529</u>
尚未使用額度	<u>\$ 3,736,579</u>	<u>4,102,980</u>	<u>4,101,413</u>
利率區間(%)	<u>1.45%~5.65%</u>	<u>1.45%~5.49%</u>	<u>0.44%~0.92%</u>

有關合併公司利率、外幣及流動性風險之暴險資訊，請詳附註六(二十三)。

合併公司提供擔保品情形，請詳附註九。

(十一)長期借款

	<u>112.3.31</u>		
	<u>利率區間</u>	<u>到期年度</u>	<u>金額</u>
無擔保銀行借款	1.200%	116.07.16	\$ 256,000
	1.200%	115.12.04	83,169
	1.200%	114.03.28	160,000
	1.200%	113.12.25	210,000
	1.750%	113.03.08	41,900
	1.52%~2.00%	115.03.13	<u>527,000</u>
			1,278,069
減：一年內到期部分			<u>(312,249)</u>
合計			<u>\$ 965,820</u>
尚未使用額度			<u>\$ 1,475,931</u>
	<u>111.12.31</u>		
	<u>利率區間</u>	<u>到期年度</u>	<u>金額</u>
無擔保銀行借款	1.075%	116.07.16	\$ 256,000
	1.075%	115.12.04	88,840
	1.075%	114.03.28	160,000
	1.075%	113.12.25	240,000
	1.625%	113.03.08	41,900
	1.40%~1.50%	114.10.14	<u>620,000</u>
			1,406,740
減：一年內到期部分			<u>(322,349)</u>
合計			<u>\$ 1,084,391</u>
尚未使用額度			<u>\$ 1,213,260</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	111.3.31		
	<u>利率區間</u>	<u>到期年度</u>	<u>金額</u>
無擔保銀行借款	0.70%	116.07.16	\$ 217,300
	0.70%	115.12.04	62,830
	0.70%	114.03.28	115,700
	0.70%	113.12.25	211,580
	1.00%	113.03.08	41,900
	1.00%	113.11.22	<u>780,000</u>
			\$ 1,429,310
減:一年內到期部分			<u>-</u>
合計			<u>\$ 1,429,310</u>
尚未使用額度			<u>\$ 1,830,690</u>

鼎翰科技為充實中期營運資金，分別與各家銀行簽訂授信合約，並定期支付利息，短期借款於合約到期前，可於融資額度內循環動用；中長期借款不得循環動用。上述借款到期日皆係以借款期間之訖日為揭露基準。其中與凱基銀行額外約定，有關鼎翰科技年度及半年度合併財務報告之財務比率承諾如下：

1. 負債比率不得高於150%；
2. (現金及約當現金+年化EBITDA) / (短期借款+1年內到期中長期借款) 不得低於1倍。

(十二)其他應付款

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
應付薪資及獎金	\$ 466,269	584,162	355,816
應付設備款	78,735	114,902	101,305
其他	<u>318,710</u>	<u>366,202</u>	<u>287,661</u>
	<u>\$ 863,714</u>	<u>1,065,266</u>	<u>744,782</u>

(十三)租賃負債

合併公司租賃負債之帳面金額如下：

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
流動	\$ 109,545	106,012	96,890
非流動	<u>102,200</u>	<u>123,214</u>	<u>177,836</u>
	<u>\$ 211,745</u>	<u>229,226</u>	<u>274,726</u>

到期分析請詳附註六(二十三)金融工具。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

租賃認列於損益之金額如下：

	<u>112年1月至3月</u>	<u>111年1月至3月</u>
租賃負債之利息費用	\$ <u>2,013</u>	<u>2,632</u>
短期租賃之費用	\$ <u>2,011</u>	<u>2,124</u>
低價值租賃資產之費用(不包含短期租賃之低價值租賃)	\$ <u>2,998</u>	<u>4,393</u>

合併公司承租若干建築物及運輸設備做為辦公室、廠房及公務車使用，租賃期間為1~6年。位於美國之辦公室及倉庫租賃約定每年依3%費率調增租賃給付。

認列於現金流量表之金額如下：

	<u>112年1月至3月</u>	<u>111年1月至3月</u>
租賃之現金流出總額	\$ <u>29,354</u>	<u>45,211</u>

(十四)員工福利

1.確定福利計畫

因前一年度報導日後未發生重大市場波動、及重大縮減、清償或其他重大一次性事項，故合併公司採用民國一十一年及一〇年十二月三十一日精算決定之退休金成本衡量及揭露期中期間之退休金成本。

合併公司列報為費用之明細如下：

	<u>112年1月至3月</u>	<u>111年1月至3月</u>
營業成本	\$ 73	87
推銷費用	18	23
管理費用	106	59
研究發展費用	<u>26</u>	<u>16</u>
	\$ <u>223</u>	<u>185</u>

2.確定提撥計畫

合併公司民國一十二年及一十一年一月一日至三月三十一日確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為16,424千元及15,529千元，已提撥至勞工保險局。

3.海外子公司則依當地法律適用確定提撥退休辦法，民國一十二年及一十一年一月一日至三月三十一日認列之退休金費用各為15,575千元及13,106千元。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十五)所得稅

1.合併公司所得稅費用如下：

	<u>112年1月至3月</u>	<u>111年1月至3月</u>
當期所得稅費用		
當期產生	\$ 158,484	167,273
調整前期之當期所得稅	<u>713</u>	<u>17</u>
	<u>159,197</u>	<u>167,290</u>
遞延所得稅費用(利益)		
暫時性差異之發生	<u>(25,356)</u>	<u>32,904</u>
所得稅費用	<u>\$ 133,841</u>	<u>200,194</u>

2.合併公司認列於其他綜合損益之下的所得稅費用(利益)明細如下：

	<u>112年1月至3月</u>	<u>111年1月至3月</u>
後續可能重分類至損益之科目：		
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>\$ (2,996)</u>	<u>18,189</u>

- 合併公司民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日並無認列於權益之所得稅費用。
- 截至民國一一二年三月三十一日止，本公司及鼎翰科技之營利事業所得稅結算申報，業經稅捐稽徵機關皆核定至民國一一〇年度。
- 本公司部份投資國外子公司之盈餘，因國外營運擴充資金所需，長期暫不擬匯回，故依國際會計準則公報第12號「所得稅」A39段規定，將此盈餘財稅差異視為永久性差異處理。

(十六)權益

1.股本

本公司民國一〇八年六月十四日經股東會決議於不超過10,000千股，每股面額新台幣10元額度範圍內授權董事會於股東會決議後一年內以私募方式辦理現金增資發行新股，並於民國一〇八年十月三十日董事會決議以每股44.5元之私募價格發行普通股6,741千股，每股面額10元，計299,975千元，以民國一〇八年十一月十八日為增資基準日，相關法定登記程序已辦理完竣。

上述私募普通股及其嗣後無償配發股份之轉讓須依證券交易法第四十三條之八規定辦理，並於私募普通股交付日(民國一〇八年十二月十八日)起滿三年後，先向金融監督管理委員會辦理公開發行後，始得向證券交易所申請上櫃買賣。

本公司於民國一一一年一月十日經董事會決議，註銷庫藏股票1,600千股並消除資本公積-庫藏股票交易69,482千元，以民國一一一年一月十日為減資基準日，業已完成法定變更程序。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

本公司民國一一二年三月三十一日、一一一年十二月三十一日及三月三十一日額定股本皆為3,600,000千元(其中100,000千元係留供發行員工認股權憑證使用)，實收股本皆為2,634,854千元，每股面額均為10元。

2. 資本公積

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
股票發行溢價	\$ 639,859	639,859	639,859
可轉換公司債轉換溢價	1,229,442	1,229,442	1,229,442
庫藏股票交易	140,945	140,945	103,945
員工認股權發行溢價	24,378	24,378	24,378
轉換公司債應付利息補償金	18,674	18,674	18,674
員工認股權	1,543	1,543	1,543
採權益法認列關聯企業變動數	82,157	82,247	79,476
	<u>\$ 2,136,998</u>	<u>2,137,088</u>	<u>2,097,317</u>

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得按股東原有股份之比例以已實現之資本公積發給新股或現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

3. 法定盈餘公積

公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

4. 特別盈餘公積

本公司依證券主管機關規定於分派盈餘時，應就當年度發生之股東權益減項自可分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派。嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，而帳列股東權益項下之土地重估增值及累積轉換調整數依規定轉入保留盈餘之金額為302,149千元，依規定提列相同數額之特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。截至民國一一二年及一一一年三月三十一日止，該項特別盈餘公積餘額皆為302,149千元。

依金管會規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

5.盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定，年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，股東股利之發放由董事會擬妥盈餘分配案，經股東會決議後辦理，其中現金股利不得低於股票股利總額之百分之十，但現金股利每股若低於0.2元則不予以發放改以股票股利發放。

本公司分別於民國一一二年三月十五日經董事會擬提議民國一一一年度盈餘分配案及一一一年六月二十一日經股東常會決議民國一一〇年度盈餘分配案，有關分派予股東情形如下：

	111年度		110年度	
	配股率(元)	金額	配股率(元)	金額
分派予普通股業主之股利：				
現金	\$ 4.00	<u>1,053,942</u>	2.50	<u>658,714</u>

6.庫藏股票

本公司依證券交易法第二十八條之二規定，為轉讓股份予員工買回庫藏股為1,600千股，買回成本為85,482千元，並於民國一一一年一月全數註銷，請詳股本之說明。

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押，於未轉讓前，並不得享有股東權益。

另，截至民國一一二年及一一一年三月三十一日止，子公司鼎翰科技持有本公司普通股皆為14,800千股，買回成本為506,043千元及506,085千元，列於庫藏股票項下。

本公司於民國一一一年度及一一〇年度，將子公司鼎翰科技持有本公司普通股所享之股利收入分別為37,000千元及20,400千元，自採用權益法認列子公司利益之份額轉列資本公積-庫藏股票交易項下。

7.其他權益

	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額
民國112年1月1日	\$ (359,558)
換算國外營運機構淨資產所產生之兌換差額	<u>4,501</u>
民國112年3月31日餘額	<u>\$ (355,057)</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額
民國111年1月1日	\$ (531,125)
換算國外營運機構淨資產所產生之兌換差額	157,828
民國111年3月31日餘額	<u>\$ (373,297)</u>

(十七)股份基礎給付

合併公司民國一十二年及一十一年一月一日至三月三十一日間股份基礎給付無重大變動，相關資訊請參閱民國一十一年度合併財務報告。

(十八)客戶合約之收入

1.收入之細分

	112年1月至3月		
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：			
亞 洲	\$ 975,405	508,187	1,483,592
美 洲	236,806	1,028,550	1,265,356
歐 洲	482,469	371,308	853,777
其 他	22,638	-	22,638
	<u>\$ 1,717,318</u>	<u>1,908,045</u>	<u>3,625,363</u>
主要產品線：			
整流器	\$ 1,717,318	-	1,717,318
條碼列印機	-	1,908,045	1,908,045
	<u>\$ 1,717,318</u>	<u>1,908,045</u>	<u>3,625,363</u>
	111年1月至3月		
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：			
亞 洲	\$ 1,147,684	500,148	1,647,832
美 洲	286,091	924,901	1,210,992
歐 洲	512,475	337,034	849,509
其 他	43,595	-	43,595
	<u>\$ 1,989,845</u>	<u>1,762,083</u>	<u>3,751,928</u>
主要產品線：			
整流器	\$ 1,989,845	-	1,989,845
條碼列印機	-	1,762,083	1,762,083
	<u>\$ 1,989,845</u>	<u>1,762,083</u>	<u>3,751,928</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.合約餘額

	<u>112.3.31</u>	<u>111.12.31</u>	<u>111.3.31</u>
應收票據及應收帳款	\$ 2,911,637	3,053,974	3,257,818
減：備抵損失	<u>(45,056)</u>	<u>(37,506)</u>	<u>(37,839)</u>
合 計	<u>\$ 2,866,581</u>	<u>3,016,468</u>	<u>3,219,979</u>

應收票據及應收帳款及其減損之揭露請詳附註六(三)。

(十九)營業外收益及費損

1.利息收入

合併公司之利息收入明細如下：

	<u>112年1月至3月</u>	<u>111年1月至3月</u>
銀行存款利息	\$ <u>8,046</u>	<u>3,328</u>

2.其他收入

	<u>112年1月至3月</u>	<u>111年1月至3月</u>
租金收入	\$ 1,926	2,251
其 他	<u>17,874</u>	<u>9,731</u>
	<u>\$ 19,800</u>	<u>11,982</u>

3.其他利益及損失

	<u>112年1月至3月</u>	<u>111年1月至3月</u>
處分不動產、廠房及設備損失	\$ (130)	(568)
外幣兌換利益(損失)	(3,426)	68,318
透過損益按公允價值衡量之金融工具損失	(4,398)	(14,983)
不動產、廠房及設備減損迴轉利益	-	711
其 他	<u>2,181</u>	<u>(2,563)</u>
	<u>\$ (5,773)</u>	<u>50,915</u>

4.財務成本

	<u>112年1月至3月</u>	<u>111年1月至3月</u>
利息費用	\$ (16,882)	(6,785)
減：利息資本化	53	218
其他財務費用	<u>(487)</u>	<u>(512)</u>
	<u>\$ (17,316)</u>	<u>(7,079)</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二十)員工及董事酬勞

依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應先提撥至少百分之四，但以不超過百分之十為員工酬勞，並提撥不超過百分之一為董事酬金。

本公司如有以前年度累積虧損，於當年度有獲利須提撥員工酬勞及董事酬勞金之前，應先彌補虧損，其餘額再依前項比例提撥；又員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

前項董事酬勞金僅得以現金為之。員工酬勞及董事酬勞金分派案，應由董事會決議，並報告股東會。

本公司民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日員工酬勞估列金額分別為20,340千元及29,350千元，董事酬勞金估列金額分別為2,840千元及4,890千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上本公司章程訂定之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業費用。若實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異列為發放年度之損益。本公司民國一一一年度及一一〇年度員工酬勞估列金額分別為139,206千元及64,897千元，董事酬勞金估列金額分別為19,886千元及10,816千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上本公司章程訂定之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業費用。相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。前述董事會決議分派之員工及董事酬勞金額與本公司民國一一一年度及一一〇年度合併財務報告估列金額並無差異。

(二十一)每股盈餘

1.基本每股盈餘

	<u>112年1月至3月</u>	<u>111年1月至3月</u>
本期淨利	\$ <u>230,317</u>	<u>386,036</u>
加權平均流通在外股數(千股)	<u>248,685</u>	<u>249,468</u>
基本每股盈餘(元)	<u>0.93</u>	<u>1.55</u>

2.稀釋每股盈餘

	<u>112年1月至3月</u>	<u>111年1月至3月</u>
計算稀釋每股盈餘之本期淨利	\$ <u>230,317</u>	<u>386,036</u>
加權平均流通在外股數(千股)	248,685	249,468
員工酬勞	<u>1,291</u>	<u>1,077</u>
用以計算稀釋每股盈餘之當期流通在外普通股加權平均股數(千股)	<u>249,976</u>	<u>250,545</u>
稀釋每股盈餘(元)	<u>0.92</u>	<u>1.54</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二十二)組織重組下之處分子公司

鼎翰科技於民國一一年七月一日與子公司TSCAA簽訂股權買賣合約，出售鼎翰科技持有5%之PTNX US股權，股份轉讓完成後，以民國一一年七月一日為合併基準日，TSCAA吸收合併持股100%之子公司PTNX US。此交易屬共同控制下之組織架構重組，視為權益交易處理。

1.收取之對價

	<u>PTNX US</u>
總收取對價	\$ <u>48,219</u>

2.對喪失控制之資產及負債之分析

	<u>PTNX US</u>
流動資產	
現金及約當現金	\$ 2,010
應收帳款淨額	4,192
應收帳款—關係人淨額	1,012
其他應收款—關係人	2,354
存 貨	2,516
預付款項	1,056
其他流動資產	10
非流動資產	
不動產、廠房及設備	\$ 48
無形資產	18
商 譽	27,738
顧客關係	277
專門技術	842
遞延所得稅資產	13,676
流動負債	
應付帳款	(2,643)
其他應付款	(931)
本期所得稅負債	(234)
負債準備	(23)
其他流動負債	(90)
非流動負債	
遞延所得稅負債	(814)
其他非流動負債	(1,744)
處分之淨資產	\$ <u>49,270</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

3.權益交易差額

	<u>PTNX US</u>
收取之對價	\$ 48,219
處分之淨資產	(49,270)
國外營運機構財務報表換算之兌換差額調整	<u>(8,871)</u>
權益交易差額(列於資本公積減項)	<u>\$ (9,922)</u>

TSCAA於民國一一一年七月一日以母公司持有PTNX US公司之權益法帳面金額作為取得時之入帳基礎，取得股權之價款超過PTNX US淨資產帳面金額之部分，係調整資本公積9,922千元，本公司依所享有比例調整，綜上，除直接認列於權益項目之所得稅列於資本公積外，對合併公司財務報告未產生影響。

(二十三)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。

(2)信用風險集中情況

由於合併公司有廣大客戶群，並未顯著集中與單一客戶進行交易，並無銷貨收入佔營業收入金額10%。

(3)應收款項及債券之信用風險

應收票據及應收帳款之信用風險暴險資訊請詳附註六(三)。

2.流動性風險

下表為金融負債之合約到期日，包含估計利息但不包含淨額協議之影響。

	<u>帳面金額</u>	<u>合 約 現金流量</u>	<u>1年</u>	<u>1-2年</u>	<u>2-5年</u>	<u>超過5年</u>
112年3月31日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 1,379,471	1,382,704	1,382,704	-	-	-
應付帳款	1,560,662	1,560,662	1,560,662	-	-	-
其他應付款	863,714	863,714	863,714	-	-	-
租賃負債	211,745	242,688	122,268	106,502	13,918	-
存入保證金	2,221	2,221	2,221	-	-	-
長期借款(含一年內到期)	1,278,069	1,293,442	320,396	333,514	639,532	-
衍生金融負債						
遠期外匯合約	<u>5,607</u>	<u>5,607</u>	<u>5,607</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 5,301,489</u>	<u>5,351,038</u>	<u>4,257,572</u>	<u>440,016</u>	<u>653,450</u>	<u>-</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	帳面金額	合 約 現金流量	1年	1-2年	2-5年	超過5年
111年12月31日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 1,466,515	1,471,972	1,471,972	-	-	-
應付帳款	1,648,557	1,648,557	1,648,557	-	-	-
其他應付款	1,065,266	1,065,266	1,065,266	-	-	-
租賃負債	229,226	241,713	118,899	105,058	17,756	-
存入保證金	2,217	2,217	2,217	-	-	-
長期借款(含一年內到期)	1,406,740	1,422,754	330,430	859,760	232,564	-
衍生金融負債						
遠期外匯合約	2,392	2,392	2,392	-	-	-
	<u>\$ 5,820,913</u>	<u>5,854,871</u>	<u>4,639,733</u>	<u>964,818</u>	<u>250,320</u>	<u>-</u>
111年3月31日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 944,529	945,060	945,060	-	-	-
應付帳款	1,740,311	1,740,311	1,740,311	-	-	-
其他應付款	744,782	744,782	744,782	-	-	-
租賃負債	274,726	292,001	108,319	103,650	80,032	-
存入保證金	2,518	2,518	2,518	-	-	-
長期借款	1,429,310	1,441,618	50,275	841,127	532,062	18,154
衍生金融負債						
遠期外匯合約	7,443	7,443	7,443	-	-	-
	<u>\$ 5,143,619</u>	<u>5,173,733</u>	<u>3,598,708</u>	<u>944,777</u>	<u>612,094</u>	<u>18,154</u>

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

3. 匯率風險

(1) 匯率風險之暴險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	112.3.31		111.12.31		111.3.31	
	匯率	台幣	匯率	台幣	匯率	台幣
金融資產						
<u>貨幣性項目</u>						
美金	\$ 30.45	2,299,605	30.71	2,986,582	28.625	2,158,491
歐元	33.15	1,006,175	32.72	885,939	31.92	800,883
日幣	0.2288	190,200	0.2324	200,138	0.2353	192,248
港幣	3.8790	442,827	3.9380	468,598	3.6560	520,781
人民幣	4.4310	1,808,359	4.4080	1,976,945	4.5060	1,805,782
韓元	0.0234	<u>1,263</u>	0.0244	<u>2,390</u>	0.0237	<u>1,141</u>
		\$ <u>5,748,429</u>		<u>6,520,592</u>		<u>5,479,326</u>
<u>衍生商品</u>						
美元	\$ 30.45	355	30.71	1,798	28.625	761
歐元	33.15	<u>-</u>	32.72	<u>-</u>	31.92	<u>984</u>
		\$ <u>355</u>		<u>1,798</u>		<u>1,745</u>
金融負債						
<u>貨幣性項目</u>						
美元	\$ 30.45	851,188	30.71	751,186	28.625	699,444
歐元	33.15	245,010	32.72	513,442	31.92	388,244
日幣	0.2288	97,693	0.2324	59,307	0.2353	69,485
港幣	3.8790	1,331	3.9380	1,534	3.6560	1,255
人民幣	4.4310	573,303	4.4080	609,884	4.5060	786,188
韓元	0.0234	<u>1,295</u>	0.0244	<u>2,509</u>	0.0237	<u>1,140</u>
		\$ <u>1,769,820</u>		<u>1,937,862</u>		<u>1,945,756</u>
<u>衍生商品</u>						
美元	\$ 30.45	4,521	30.71	2,392	28.625	6,952
歐元	33.15	<u>1,086</u>	32.72	<u>-</u>	31.92	<u>491</u>
		\$ <u>5,607</u>		<u>2,392</u>		<u>7,443</u>

(2) 敏感性分析

合併公司貨幣性項目之匯率風險主要來自於以外幣計價之金融資產及金融負債，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一一二年及一一一年三月三十一日當新台幣相對於上表所列外幣貶值或升值3%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日之稅前淨利將分別增加或減少119,201千元及105,836千元；兩期分析係採用相同基礎。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(3)貨幣性項目之兌換損益

由於合併公司功能性貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日外幣兌換(損)益(含已實現及未實現)分別為(3,426)千元及68,318千元。

4.利率分析

合併公司之金融資產及金融負債利率暴險於本附註之流動性風險管理中說明。

下列敏感度分析係依衍生及非衍生工具於報導日之利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設報導日流通在外之負債金額於整年度皆流通在外。合併公司內部向主要管理階層報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少1%，此亦代表管理階層對利率之合理可能變動範圍之評估。

若利率增加或減少1%，在所有其他變數維持不變之情況下，合併公司民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日之稅前淨利將減少或增加26,575千元及23,738千元，主因係合併公司之變動利率銀行借款所致。

5.其他價格風險：

如報導日權益證券價格變動(兩期分析係採用相同基礎，且假設其他變動因素不變)，對綜合損益項目之影響如下：

<u>報導日證券價格</u>	<u>112年1月至3月</u>		<u>111年1月至3月</u>	
	<u>其他綜合損益稅後金額</u>	<u>稅後損益</u>	<u>其他綜合損益稅後金額</u>	<u>稅後損益</u>
	上漲1%	\$ -	<u>2,535</u>	-
下跌1%	\$ -	<u>(2,535)</u>	-	<u>(2,501)</u>

6.公允價值資訊

(1)金融工具之種類及公允價值

合併公司透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債係以重複性為基礎，按公允價值衡量。各種類金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量金融工具之帳面金額為公允價值之合理近似值者，及於活絡市場無報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	112.3.31				
	帳面金額	公允價值			合 計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
融資產					
受益憑證	\$ 250,198	250,198	-	-	250,198
理財產品	265,860	-	-	265,860	265,860
衍生金融資產	355	-	355	-	355
國外基金	4,122	-	-	4,122	4,122
小 計	<u>520,535</u>	<u>250,198</u>	<u>355</u>	<u>269,982</u>	<u>520,535</u>
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	3,386,616	-	-	-	-
應收票據及帳款	2,866,581	-	-	-	-
其他應收款	91,752	-	-	-	-
存出保證金	83,194	-	-	-	-
小 計	<u>6,428,143</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
其他金融資產					
結構性定期存款	389,928	-	-	389,928	389,928
合 計	<u>\$ 7,338,606</u>	<u>250,198</u>	<u>355</u>	<u>659,910</u>	<u>910,463</u>
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
融負債					
衍生金融負債	\$ 5,607	-	5,607	-	5,607
按攤銷後成本衡量之金融負債					
銀行借款	2,657,540	-	-	-	-
應付帳款	1,560,662	-	-	-	-
其他應付款	863,714	-	-	-	-
租賃負債	211,745	-	-	-	-
存入保證金	2,221	-	-	-	-
小 計	<u>5,295,882</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
合 計	<u>\$ 5,301,489</u>	<u>-</u>	<u>5,607</u>	<u>-</u>	<u>5,607</u>
111.12.31					
	帳面金額	公允價值			合 計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
融資產					
衍生金融資產	\$ 1,798	-	1,798	-	1,798
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
國外基金	4,157	-	-	4,157	4,157

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

		111.12.31			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合計
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	3,595,681	-	-	-	-
應收票據及帳款	3,016,468	-	-	-	-
其他應收款	105,789	-	-	-	-
其他金融資產	682,508	-	-	-	-
小計	7,400,446	-	-	-	-
合計	<u>\$ 7,406,401</u>	<u>-</u>	<u>1,798</u>	<u>4,157</u>	<u>5,955</u>
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
衍生金融負債	\$ 2,392	-	2,392	-	2,392
按攤銷後成本衡量之金融負債					
銀行借款	2,873,255	-	-	-	-
應付帳款	1,648,557	-	-	-	-
其他應付款	1,065,266	-	-	-	-
租賃負債	229,226	-	-	-	-
存入保證金	2,347	-	-	-	-
小計	5,818,651	-	-	-	-
合計	<u>\$ 5,821,043</u>	<u>-</u>	<u>2,392</u>	<u>-</u>	<u>2,392</u>
		111.3.31			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
受益憑證	\$ 250,090	250,090	-	-	250,090
衍生金融資產	1,745	-	1,745	-	1,745
小計	251,835	250,090	1,745	-	251,835
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	2,471,703	-	-	-	-
應收票據及帳款	3,219,979	-	-	-	-
其他應收款	88,589	-	-	-	-
其他金融資產	530,406	-	-	-	-
小計	6,310,677	-	-	-	-
合計	<u>\$ 6,562,512</u>	<u>250,090</u>	<u>1,745</u>	<u>-</u>	<u>251,835</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	111.3.31				
	帳面金額	公允價值			合計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
融負債					
衍生金融負債	\$ 7,443	-	7,443	-	7,443
按攤銷後成本衡量之金融負債					
銀行借款	2,373,839	-	-	-	-
應付帳款	1,740,311	-	-	-	-
其他應付款	744,782	-	-	-	-
租賃負債	274,726	-	-	-	-
存入保證金	2,518	-	-	-	-
小計	5,136,176	-	-	-	-
合計	\$ 5,143,619	-	7,443	-	7,443

(2) 衡量公允價值所採用之評價技術及假設

A. 非衍生金融工具

金融工具如有活絡市場公開報價時，則以活絡市場之公開報價為公允價值。主要交易所及經判斷為熱門券之中央政府債券櫃台買賣中心公告之市價，皆屬上市（櫃）權益工具及有活絡市場公開報價之債務工具公允價值之基礎。

若能及時且經常自交易所、經紀商、承銷商、產業公會、訂價服務機構或主管機關取得金融工具之公開報價，且該價格代表實際且經常發生之公平市場交易者，則該金融工具有活絡市場公開報價。如上述條件並未達成，則該市場視為不活絡。一般而言，買賣價差甚大、買賣價差顯著增加或交易量甚少，皆為不活絡市場之指標。

除上述有活絡市場之金融工具外，其餘金融工具之公允價值係以評價技術或參考交易對手報價取得。透過評價技術所取得之公允價值可參照其他實質上條件及特性相似之金融工具之現時公允價值、現金流量折現法或以其他評價技術，包括以報導日可取得之市場資訊運用模型計算而得（例如櫃買中心參考殖利率曲線、Reuters商業本票利率平均報價）。

B. 衍生金融工具

係根據廣為市場使用者所接受之評價模型評價，例如折現法及選擇權定價模型。遠期外匯合約通常係根據目前之遠期匯率評價。

(3) 公允價值等級間之移動

合併公司於民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日公允價值衡量評價方式皆無任何層級間之移轉。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(4)第三等級之變動明細表

	透過損益按 公允價值衡量 之金融資產
民國112年1月1日	\$ -
總利益或損失	
認列於損益	(35)
取得	655,788
重分類	<u>4,157</u>
民國112年3月31日	<u>\$ 659,910</u>

上述總利益或損失，係列報於「其他利益及損失」。其中與民國一一二年及一一一年三月三十一日仍持有之資產相關者如下：

	112年 1月至3月	111年 1月至3月
總利益或損失		
認列於損益(列報於「其他利益及損失」)	\$ (35)	-

(5)重大不可觀察輸入值(第三等級)之公允價值衡量之量化資訊

本公司公允價值衡量歸類為第三等級主要透過損益按公允價值衡量之金融資產，包含其他金融資產及國外基金投資，相關說明請詳附註六(二)。

本公司持有之國外基金投資公允價值歸類為第三等級具單一重大不可觀察輸入值，重大不可觀察輸入值之資訊列表如下：

項目	評價技術	重大不可 觀察輸入值	重大不可觀察 輸入值與公允 價值關係
透過損益按公允價值衡量之金融資產-國外基金	淨資產價值法	• 淨資產價值	• 淨資產價值愈高，公允價值愈高

(二十四)財務風險管理

合併公司財務風險管理目標及政策與民國一一一年度合併財務報告所揭露者無重大變動。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二十五)資本管理

合併公司資本管理目標、政策及程序與民國一一一年度合併財務報告所揭露者一致；另作為資本管理之項目之彙總量化資料與民國一一一年度合併財務報告所揭露者亦無重大變動。相關資訊請參閱民國一一一年度合併財務報告。

(二十六)非現金交易之投資及籌資活動

合併公司於民國一一二年及一一一年一月一日至三月三十一日並無非現金交易投資及籌資活動。

來自籌資活動之負債之調節如下表：

	<u>112.1.1</u>	<u>現金流量</u>	<u>非現金之變動</u>			<u>112.3.31</u>
			<u>匯率變動</u>	<u>其他</u>	<u>租賃給付之變動</u>	
短期借款	\$ 1,466,515	(87,044)	-	-	-	1,379,471
長期借款(含一年內到期)	1,406,740	(128,671)	-	-	-	1,278,069
租賃負債	229,226	(24,345)	(3,278)	2,013	8,129	211,745
存入保證金	2,217	4	-	-	-	2,221
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 3,104,698</u>	<u>(240,056)</u>	<u>(3,278)</u>	<u>2,013</u>	<u>8,129</u>	<u>2,871,506</u>

	<u>111.1.1</u>	<u>現金流量</u>	<u>非現金之變動</u>			<u>111.3.31</u>
			<u>匯率變動</u>	<u>其他</u>	<u>租賃給付之變動</u>	
短期借款	\$ 921,426	23,103	-	-	-	944,529
長期借款	1,549,310	(120,000)	-	-	-	1,429,310
租賃負債	304,151	(38,694)	5,779	2,632	838	274,706
存入保證金	2,347	171	-	-	-	2,518
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 2,777,234</u>	<u>(135,420)</u>	<u>5,779</u>	<u>2,632</u>	<u>838</u>	<u>2,651,063</u>

七、關係人交易

(一)母公司與最終控制者

本公司為合併公司之最終控制者。

(二)主要管理人員報酬

主要管理人員報酬包括：

	<u>112年1月至3月</u>	<u>111年1月至3月</u>
短期員工福利	\$ 54,626	45,037
退職後福利	427	318
股份基礎給付	428	932
	<u>\$ 55,481</u>	<u>46,287</u>

有關股份基礎給付之說明請詳附註六(十七)。

八、質押之資產：無。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

合併公司向銀行融資而提供之保證票據明細如下：

	112.3.31	111.12.31	111.3.31
新台幣	\$ 2,411,900	2,411,900	1,369,210
美金	21,000	21,000	21,000

截至民國一一二年及一一一年三月三十一日止，合併公司無已開立信用狀尚未使用餘額。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

十二、其他

(一)員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	112年1月至3月			111年1月至3月		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	319,814	205,905	525,719	251,646	298,618	550,264
勞健保費用	28,809	29,623	58,432	24,824	25,777	50,601
退休金費用	21,467	10,755	32,222	14,658	14,162	28,820
董事酬金	-	10,076	10,076	-	11,549	11,549
其他員工福利費用	17,666	14,149	31,815	22,975	7,205	30,180
折舊費用	178,408	29,078	207,486	164,768	28,167	192,935
攤銷費用	3,697	30,381	34,078	3,593	29,255	32,848

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一一二年一月一日至三月三十一日合併公司依編製準則之規定，應揭露之重大交易事項相關資訊如下：

1. 資金貸與他人：

單位：新台幣千元

編號	貸出資金 之公司	貸與 對象	往來 科目	是否 為關 係人	本期最 高金額 (註4)	期末 餘額	實際動 支金額	利率 區間	資金貸 與性質 (註1)	業務 往來 金額	有短期融 通資金必 要之原因	提列備 抵損失 金額	擔 保 品		對個別對象 資金貸與 限額(註2)	資金貸 與限額 (註3)
													名稱	價值		
1	鼎翰科技	TSCAA	其他應 收款	是	213,360	-	-	-%	2	-	已於民國 112年3月15 日註銷	-	無	-	-	-
2	鼎翰科技	DLS	其他應 收款	是	304,800	304,500	-	-%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,077,155	2,154,311
3	鼎翰科技	Mosfortico Investments sp. z o.o.	其他應 收款	是	-	165,750	-	-%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,077,155	2,154,311

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

註1：短期融通資金之必要者。

註2：鼎翰科技資金貸與有短期融通資金性質之公司或行號，個別對象貸與金額以不超過鼎翰科技淨值20%為限。

註3：鼎翰科技資金貸與他人之總額以不超過鼎翰科技淨額40%為限。

註4：係按民國一十二年二月二十八日美金匯率30.48換算台幣表達。

2. 為他人背書保證：

單位：新台幣千元

編號	背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額(註2)	本期最高背書保證餘額(註4)	期末背書保證餘額	實際動支金額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額(註3)	屬母公司對子公司背書保證	屬子公司對母公司背書保證	屬對大陸地區背書保證
		公司名稱	關係(註1)										
1	鼎翰科技	TSCAA	2	2,154,311	365,760	365,400	-	-	6.79 %	3,231,466	N	N	N

註1：本公司之子公司。

註2：鼎翰科技對單一企業背書保證限額以不超過鼎翰科技淨值40%為限。

註3：鼎翰科技背書保證限額以不超過鼎翰科技淨值60%為限。

註4：係按民國一十二年二月二十八日美金匯率30.48換算台幣表達。

3. 期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

單位：新台幣千元

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期 末				備 註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值	
本公司	Applied WirelessIdentifications Group, Inc.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	243	-	-	-	
本公司	Third Dimension (3D)Semiconductor, Inc.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	921	-	-	-	
本公司	元大得利貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	12,047	200,170	-	200,170	
本公司	台新1699貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	3,623	50,028	-	50,028	
本公司	Achi Capital Partners Fund LP	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動	-	4,122	-	4,122	

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

單位：新台幣千元

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間(註1)	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	TSCH	子公司	銷貨	(124,429)	(3) %		-		213,102	7 %	
本公司	TSCA	孫公司	銷貨	(132,110)	(4) %		-		187,547	7 %	
本公司	陽信長威	孫公司	進貨	413,197	18 %		-		(341,664)	(22) %	註2
鼎翰科技	TSCAE	子公司	銷貨	(302,436)	(8) %		-		681,945	24 %	
鼎翰科技	TSCAA	子公司	銷貨	(200,132)	(6) %		-		413,783	14 %	
鼎翰科技	天津國聚	子公司	銷貨	(172,832)	(5) %		-		156,705	5 %	
鼎翰科技	天津國聚	子公司	進貨	107,122	5 %		-		(141,837)	(9) %	

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

註1：月結30-135天，必要時視其資金需求調整之。

註2：應付帳款係以淨額列示。

註3：相關交易業已沖銷，請參見附註十三(一)10。

8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額(註1)	提列備抵損失金額
					金額	處理方式		
本公司	TSCH	子公司	213,102	2.09%	-		57,465	-
本公司	TSCA	孫公司	187,547	2.36%	-		46,466	-
鼎翰科技	TSCAE	子公司	681,945	1.83%	-		132,227	-
鼎翰科技	TSCAE	子公司	874	-	-		-	-
鼎翰科技	TSCAA	子公司	413,783	2.07%	-		43,363	-
鼎翰科技	TSCAA	子公司	1,614	-	-		275	-
鼎翰科技	天津國聚	子公司	156,705	3.93%	-		61,904	-
天津國聚	鼎翰科技	子公司	141,837	4.66%	-		58,088	-

註1：截至查核報告日止。

註2：相關交易業已沖銷，請參見附註十三(一)10。

9. 從事衍生工具交易：請詳附註六(二)。

10. 母子公司間業務關係及重要交易往來情形：

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	112年第一季交易往來情形			佔合併總營業收入或總資產之比率
				科目	金額	交易條件	
0	本公司	TSCE	1	推銷費用—佣金支出	32,047	按月支付	0.85 %
0	本公司	TSCE	1	應付費用	53,390		0.29 %
0	本公司	TSCJ	1	銷貨收入	75,152	註三	1.98 %
0	本公司	TSCJ	1	應收帳款	52,839		0.29 %
0	本公司	TSCH	1	銷貨收入	124,429	按月支付	3.28 %
0	本公司	TSCH	1	應收帳款	213,102		1.17 %
0	本公司	TSCH	1	其他應收款	430		- %
0	本公司	TSCH	1	應付費用	62		- %
0	本公司	鼎翰科技	1	銷貨收入	156	註三	- %
0	本公司	鼎翰科技	1	應收帳款	164		- %
0	本公司	TSCA	1	銷貨收入	132,110	註三	3.49 %
0	本公司	TSCA	1	推銷費用—佣金支出	1,601		0.04 %
0	本公司	TSCA	1	應收帳款	187,547		1.03 %
0	本公司	TSCA	1	其他應收款	2,636		0.01 %
0	本公司	TSCA	1	應付費用	1,455		0.01 %
0	本公司	上海瀚科	1	銷貨收入	96,407	按月支付	2.54 %
0	本公司	上海瀚科	1	應收帳款	148,597		0.82 %
0	本公司	上海瀚科	1	其他應收款	120		- %
0	本公司	上海瀚科	1	進貨	58,051		1.53 %
0	本公司	上海瀚科	1	應付帳款	59,618		0.33 %
0	本公司	陽信長威	1	進貨	413,197	註四	10.91 %
0	本公司	陽信長威	1	應付帳款	341,664	註五	1.88 %
0	本公司	天津長威	1	進貨	48,533		1.28 %
0	本公司	天津長威	1	應付帳款	4,599		0.03 %

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人 之 關係	112年第一季交易往來情形			佔合併總營業收入 或總資產之比率
				科目	金額	交易條件	
0	本公司	天津長威	1	其他應付款	60,257		0.33 %
1	TSCE	本公司	2	銷貨收入	32,047	註三	0.85 %
1	TSCE	本公司	2	應收帳款	53,390		0.29 %
2	TSCH	TSCE	3	佣金支出	631		0.02 %
2	TSCH	TSCE	3	應付費用	247		- %
3	TSCA	TSCAA	3	其他應付費用	1,560		0.01 %
3	TSCA	TSCAA	3	其他應收款	1,507		0.01 %
4	陽信長威	本公司	2	銷貨收入	413,197	註三	10.91 %
4	陽信長威	本公司	2	應收帳款	341,664		1.88 %
4	陽信長威	上海瀚科	3	銷貨收入	243,991	註三	6.44 %
4	陽信長威	上海瀚科	3	應收帳款	322,745		1.78 %
5	天津長威	本公司	2	銷貨收入	48,533	註三	1.28 %
5	天津長威	本公司	2	應收帳款	4,599		0.03 %
5	天津長威	本公司	2	其他應收款	60,257		0.33 %
5	天津長威	陽信長威	3	銷貨收入	35,548	註三	0.94 %
5	天津長威	陽信長威	3	應收帳款	35,247		0.19 %
5	天津長威	上海瀚科	3	其他應收款	624		- %
5	天津長威	上海瀚科	3	其他營業外收入	1,885		0.05 %
5	天津長威	上海瀚科	3	其他營業外收入	320		0.01 %

註一、編號之填寫方式如下：

1.0代表母公司。

2.子公司依公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註二、與交易人之關係種類標示如下：

1.母公司對子公司。

2.子公司對母公司。

3.子公司對子公司。

註三：銷售價格按一般市場價格為準。收款期間為月結90~180天。

註四：加工費係採成本加成，收款期間為月結90~180天。

註五：付款期限為進貨後月結180天。

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一十二年一月一日至三月三十一日合併公司之轉投資事業資訊如下：

單位：新台幣千元

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
本公司	Ever Energetic	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	665,501	665,501	21,175	100.00 %	1,553,463	(7,877)	(7,877)	子公司 (註2)
本公司	Ever Winner	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	465,127	465,127	16,010	100.00 %	1,704,687	45,629	45,629	子公司 (註2)
本公司	Skyrise	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	2,845	2,845	50	100.00 %	1,840	-	-	子公司 (註2)
本公司	TSCE	德國	一般進出口業務	10,972	10,972	-	100.00 %	66,856	5,321	5,321	子公司 (註2)
本公司	TSCJ	日本	整流器之買賣業務	28,689	28,689	2	100.00 %	114,968	5,169	5,169	子公司 (註1)
本公司	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	282,312	282,312	672	25.22 %	628,628	10,029	10,937	子公司 (註2)

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
本公司	鼎翰科技	台灣	條碼印表機之製造及買賣	163,728	163,728	15,453	36.34 %	1,058,820	204,329	74,253 (註1)	子公司
Ever Energetic	TSCA	美國	整流器之買賣業務	258,520	258,520	6,750	75.00 %	241,438	(15,445)	(11,584) (註2)	子公司
Ever Energetic	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	571,628	571,628	985	36.96 %	1,238,342	10,029	3,707 (註2)	子公司
Ever Winner	TSCA	美國	整流器之買賣業務	83,813	83,813	2,250	25.00 %	80,479	(15,445)	(3,861) (註2)	子公司
Ever Winner	上海瀚科	中國大陸	整流器之買賣業務	4,461	4,461	-	100.00 %	282,343	45,697	45,697 (註2)	子公司
Ever Winner	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	792,254	792,254	1,008	37.82 %	1,267,157	10,029	3,793 (註2)	子公司
TSCH	陽信長威	中國大陸	整流器之製造及買賣業務	966,119	966,119	-	100.00 %	2,356,559	(1,240)	(1,240) (註1)	子公司
TSCH	天津長威	中國大陸	晶片之製造及買賣業務	787,044	787,044	-	100.00 %	676,431	1,177	1,177 (註2)	子公司
鼎翰科技	TSCAE	德國	條碼印表機及其零件之銷售	2,943	2,943	-	100.00 %	(73,576)	(10,972)	(10,972) (註1)	子公司
鼎翰科技	TSCAA	美國	條碼印表機及其零件之銷售	1,096,621	1,096,621	16,000	100.00 %	1,038,566	(7,189)	(7,189) (註1)	子公司
鼎翰科技	TSC HK	香港	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	51,738	51,738	11,711	100.00 %	603,478	34,814	34,814 (註1)	子公司
鼎翰科技	鼎貫科技	台灣	條碼印表機及其零件之銷售	5,000	5,000	500	100.00 %	5,141	(117)	(117) (註1)	子公司
鼎翰科技	DLS	美國	印表機週邊耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	801,558	801,558	1	100.00 %	1,259,116	44,480	44,480 (註1)	子公司
鼎翰科技	TSCIN	印度	條碼印表機及其零件之銷售	2,791	2,791	710	100.00 %	1,146	(450)	(450) (註1)	子公司
鼎翰科技	TSCPL	波蘭	一般投資	31	-	-	100.00 %	(40)	(71)	(71) (註1)	子公司
TSCAE	TSCAD	阿拉伯聯合大公國	條碼印表機及其零件之銷售	8,234	8,234	-	100.00 %	(10,162)	(1,461)	(1,461) (註1)	子公司
TSCAE	TSCAS	西班牙	條碼印表機及其零件之銷售	124	124	-	100.00 %	2,786	90	90 (註1)	子公司
DLS	PPL	美國	印表機週邊耗材及標籤紙之銷售	115 (千美元)	115 (千美元)	850	100.00 %	32,050	2,413	2,413 (註1)	子公司
TSC HK	天津國聚	中國大陸	條碼印表機及其零件之產銷	45,675	45,675	-	100.00 %	647,374	35,652	35,652 (註1)	子公司
TSC HK	深圳鼎貫	中國大陸	條碼印表機及其零件之產銷	4,689	4,689	-	100.00 %	5,805	(248)	(248) (註1)	子公司

註1：係依據被投資公司經會計師核閱之財務報告認列。

註2：係依據被投資公司未經會計師核閱之財務報告認列。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

單位：新台幣千元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回						
上海瀚科	整流器之買賣業務	4,461	(三)	4,461	-	-	4,461	45,697	100.00 %	45,697	282,343	397,444
陽信長威	整流器之製造及買賣業務	1,667,160	(三)	628,196	-	-	628,196	(1,240)	100.00 %	(1,240)	2,356,559	250,864
天津長威	晶片之製造及買賣業務	387,173	(三)	387,173	-	-	387,173	1,177	100.00 %	1,177	676,431	452,102
天津國聚	條碼印表機及其零件之產銷	46,526	(三)	45,675	-	-	45,675	35,652	36.34 %	12,956	647,374	787,814
深圳鼎貫	條碼印表機及其零件之銷售	4,431	(三)	4,689	-	-	4,689	(248)	36.34 %	(90)	5,805	5,898

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

2.赴大陸地區投資限額：

本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
1,003,896	1,978,296	4,977,996

3.與大陸被投資公司間之重大交易事項：

合併公司民國一一二年一月一日至三月三十一日與大陸投資公司直接或間接之重大交易事項於編製合併報告時業已沖銷，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

(四)主要股東資訊：

單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
鼎翰科技股份有限公司		14,800,000	5.61 %

註：(1)本表主要股東資訊係由集保公司以每季最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付(含庫藏股)之普通股及特別股合計達百分之五以上資料。至於公司財務報告所記載股本與公司實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

(2)上開資料如屬股東將持股交付信託，係以受託人開立信託專戶之委託人個別分戶揭示。至於股東依據證券交易法令辦理持股超過百分之十之內部人股權申報，其持股包括本人持股加計其交付信託且對信託財產具有運用決定權股份等，有關內部人股權申報資料請參閱公開資訊觀測站。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

十四、部門資訊

合併公司營運部門資訊及調節如下：

	112年1月至3月			
	整流器部門	條碼印表機部門	調整及銷除	合計
收入				
來自外部客戶收入	\$ 1,717,318	1,908,045	-	3,625,363
部門間收入	<u>1,260,107</u>	<u>4</u>	<u>(1,260,111)</u>	<u>-</u>
收入合計	<u>\$ 2,977,425</u>	<u>1,908,049</u>	<u>(1,260,111)</u>	<u>3,625,363</u>
應報導部門損益	<u>\$ 215,996</u>	<u>278,238</u>	<u>-</u>	<u>494,234</u>
	111年1月至3月			
	整流器部門	條碼印表機部門	調整及銷除	合計
收入				
來自外部客戶收入	\$ 1,989,845	1,762,083	-	3,751,928
部門間收入	<u>1,748,778</u>	<u>8</u>	<u>(1,748,786)</u>	<u>-</u>
收入合計	<u>\$ 3,738,623</u>	<u>1,762,091</u>	<u>(1,748,786)</u>	<u>3,751,928</u>
應報導部門損益	<u>\$ 463,842</u>	<u>221,351</u>	<u>-</u>	<u>685,193</u>
應報導部門資產	整流器部門	條碼印表機部門	調整及銷除	合計
112年3月31日	<u>\$ 23,965,159</u>	<u>8,645,538</u>	<u>(14,446,320)</u>	<u>18,164,377</u>
111年12月31日	<u>\$ 24,369,174</u>	<u>8,294,769</u>	<u>(14,447,124)</u>	<u>18,216,819</u>
111年3月31日	<u>\$ 22,891,962</u>	<u>7,931,032</u>	<u>(14,195,061)</u>	<u>16,627,933</u>